

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中欧基金、汇添富、华商基金、百年资管
会议时间	2026年3月30日、2026年3月31日
会议地点	线下
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：韩江龙 副总经理、董事会秘书、财务负责人：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司未来发展战略 回复：未来，公司将在巩固现有半导体封装材料竞争优势的基础上，以客户定制化需求为牵引，以先进封装技术发展趋势为导向，构建兼具前瞻性与创新性的技术研发体系，持续优化产品结构，增强企业核心竞争力。在传统封装用封装材料领域，公司依托既有优势产品加快对外资厂商产品替代，并积极围绕现有客户以及潜在客户的新增需求进行布局并开发特色产品，从而进一步扩大公司业务规模并提升市场占有率；在先进封装材料领域，华海诚科与衡所华威将加快在技术资源、客户资源的整合，协同开展半导体封装材料工艺技术的迭代开发，加大对车载芯片、电容封装、存储类半导体器件用环氧塑封料的研发投入。同时优化产品结构、

客户结构，快速提高在高性能和先进封装环氧塑封料应用领域的领先地位。

问题二：请问公司如今的产品布局是怎样的？

回复：在传统封装领域，公司产品结构全面并已实现产业化，市场份额逐步扩大，在国内市场已具备较高的品牌知名度及市场影响力；在先进封装领域，颗粒状环氧塑封料（GMC）、FC 底填胶、高导热、低翘曲、耐高压、高可靠性等系列产品已陆续通过客户考核验证，技术水平取得业内主要封装厂商的认可。公司在加大核心技术开发的同时，注重实现核心技术的产业化，公司拥有独立自主的系统化知识产权。凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司已与相关业内领先及主要企业建立稳固的合作伙伴关系，业务规模持续扩大，有序实现研发技术的产业化落地，推动经营业绩的快速提升。公司与业内主流封装厂商均已建立长期稳定的合作关系。

问题三：阻碍公司拓宽高性能产品份额的原因是什么？除了验证时间很久之外，还有哪些因素？

回复： 1.在高性能产品领域，塑封材料在成本中占比较低，且处于芯片制造的最后环节，对产品良率影响较大，客户更换较为谨慎；2.国内部分封测厂家属于代工模式，执行设计厂家的固定 BOM 单，更换难度较大。

问题四：国内的环氧塑封料市场，如果分为基础类、高性能类和先进封装类，各自占比是多少？

回复：高性能类占比最高；基础类因单价较低，占比相对较小；先进封装类占比也较低。

问题五：公司为国产化替代做了哪些努力？

回复：长期以来，中国半导体关键材料因为缺乏技术被“卡脖子”，因而受制于人。公司以开发全系列先进封装材料为己任，专注关键技术攻关。公司以半导体产业及半导体封装行业的发展方向为指导，围绕现有产品及技术成果，在新产品研发、配方开发、工

艺优化等方面进行持续研发及技术攻关，在保持行业内技术优势地位的同时不断拓展公司产品的应用领域，为我国半导体封装材料的国产化提供了材料保障。

问题六：目前，华海已经实现对衡所华威的收购，请问整合效应体现在哪些方面？

回复：华海诚科与衡所华威的高效整合，在供应保障方面持续优化供应商结构，积极拓展本土优质资源，成功引入一批新供应商。扎实推进高风险物料的替代工作，并在多个关键零部件与品类上完成第二资源开发，均已实现量产或测试验证。通过有效管控，物料成本实现同比再降。同时，已完成对通用高频高风险物料的长期战略储备，增强了供应链韧性；在运营管理方面深化关键指标管理体系，尤其聚焦生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现，精细设定一系列严苛关键考核指标，全面覆盖质量、效率、成本和安全等关键维度。公司生产运营效率持续提升，设备产量实现同比增长，并通过流程优化达到了较高的准时交付率。产能整合顺利完成，工厂全面实行数字化管理体系，智能物流系统投入运行。公司全面推进质量管理体系建设，强化了全员质量文化与流程闭环。安全与环保管理在项目建设中同步落实，数字化与信息安全体系持续升级；在研发方面，衡所华威运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料为全球独有，积累了一批全球知名的半导体客户，有利于公司突破海外技术垄断。公司正全面整合研发体系，协同开展半导体封装材料工艺技术的迭代开发，以期快速取得高端封装材料技术突破；在市场拓展方面，公司高性能系列产品保持稳健增长，构成业绩基本盘。用于新能源汽车、IPM 智能模块、第三代半导体、先进封装等产品线均取得较为显著增长。在客户拓展与深化方面，公司积极推动大客户战略，一批重点客户项目加速落地。同时，进一步优化了渠道结构，提升了对终端客户的服务能力和市场响应速度。

综上，双方在市场布局、产品矩阵、供应链整合、产线布局、研

	<p>发资源、服务响应、联合运输、数据共享等多方面充分发挥协同效应，提升了运营效率和抗风险能力。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年3月30日、2026年3月31日